

amasan Wärmeleitpaste T12

Wärmeableitendes Füllmittel zwischen den Kontaktflächen der Halbleiter und Kühlkörper

amasan Wärmeleitpaste T12 ist eine bis zu 200°C hitzebeständige, chemisch neutrale, weiße, undurchsichtige Silikonpaste mit guter Wärmeleitfähigkeit.

amasan Wärmeleitpaste T12 trocknet nicht aus, wird nicht hart und schmilzt nicht. Sie ist konsistenzbeständig bei hohen und niedrigen Temperaturen sowie bei Lagerung.

amasan Wärmeleitpaste T12 dient als wärmeableitendes Füllmittel zwischen den Kontaktflächen der Halbleiter und Kühlkörper. Bei der Montage von Halbleitern, wie Dioden und Transistoren, wird durch das Auftragen von Wärmeleitpaste T12 die wärmeisolierende Luft durch die wärmeableitende Silikonpaste T12 ersetzt, wodurch der Wärmeübergang vom Bauelement zum Kühlkörper verbessert und dadurch die Leistungsfähigkeit des Bauelementes wesentlich gesteigert wird.



amasan Wärmeleitpaste T12 sollte gleichmäßig und dünn mit einem Pinsel oder Spachtel auf beide Kontaktflächen aufgetragen werden. Die nach dem Montieren überschüssige Menge sollte entfernt werden.

amasan Wärmeleitpaste T12 wird geliefert in **Tuben mit Injektionsspitze** mit 5 g, 35 g und 100 g Inhalt sowie in Dosen mit 250 g, 500 g und 1000 g Inhalt.

Spezifikation:

Struktur	Silikonbasis
Farbe	weiß, undurchsichtig
Konsistenz	vaselineartig
Dichte bei 25°C	2,3
Temperaturbereich	-30°C bis +200°C
Ausbluten nach 24 h bei 200°C	0,4 %
Flüchtigkeit nach 24 h bei 200°C	1,0 %
Wärmeleitfähigkeit W/mk	0,90